Description du produit

- 100% neuf et haute qualité !!
- Le flux de colophane est utilisé pour faciliter la soudure.
- Il nettoie et empêche l'oxydation du métal, ce qui permet à la soudure de créer des liaisons mécaniques et électriques solides et durables.
- Il agit également comme un agent mouillant, augmentant le débit de brasage et l'efficacité du processus de brasage.
- Parfait pour les téléphones mobiles, les cartes PC et les autres systèmes sophistiqués de soudage par flux sur puce électronique.

Caractéristiques

Produit: BST-706

Point de fusion: 138

Poids: 500g

Ingrédients: Sn99%, Cu0.7%, Ag0.3%

SOLDER PASTE

Lead-free medium temperature

500g

Low residue / Rapid welding / lead free / Solder spot bright

Product Usage

MODEL	BST-706
SHELF LIFE	6 months
INGREDIENT	Sn42/Bi58
WEIGHT	500g
MELTING POINT	138°C

Having a large insulation resistance does not corrode the PCB, and the requirements for no-cleaning can be achieved.

High impedance, full and bright solder, low residue

Welding requirements for a wide range of products

TESTING EFFECT

UNIFORM SOLDER JOINT
MEDIUM TEMPERATURE MELTING POINT

PRODUCT SIZE

63.0MM

75MM

52MM